

Doc.No: NR020523

2002年5月23日

## 半導体パッケージ基板の外観検査装置を販売

大日本スクリーン製造株式会社(本社:京都市上京区)の電子機器カンパニー(社長:葛川幸隆)は6月3日から、BGA・CSPパッケージ基板用最終外観検査装置「FP-1000F」を販売します。

携帯電話などに多用されるBGA(Ball Grid Array)、CSP(Chip Size Package)などの半導体パッケージ基板は、高密度化により目視検査は限界に近づきつつあります。

FP-1000Fは、電子部品を実装前のBGA・CSP基板を光学的に検査する装置で、IC類のハンダ接合エリアの微細な欠陥、接続用ボール部やはんだ付けを行わないソルダレジスト部分(緑色の部分)のキズを全自動で検知するとともに、生産ラインで混入した異物、変色、金メッキ未着、配線パターンの欠損なども安定して検出します。

\* この装置は6月5日から東京・有明ビッグサイトで開催されるJPCA Show 2002で実機展示します。

### < 特長 >

1. 目的や対象基板に応じてさまざまな欠陥検出を行う最適な照明を準備。パッケージ基板上の電解金メッキ、無電解金メッキ、ソルダレジストの欠陥を確実に検査。
2. 5,150画素/ラインの高解像CCDカメラと当社独自の画像処理システム搭載で、欠陥画像を明確に識別。検査基準に応じて4.2 $\mu$ mから20 $\mu$ mまでの分解能を選択可能。
3. 相対濃度比較法、絶対濃度比較法、パターンマッチ法、測長法など豊富な検査処理ソフトの組み合わせにより検出性能を向上させるとともに、誤判定率の大幅な低減を実現。
4. 最適なカメラ分解能の選択と検査アルゴリズムの組み合わせにより、顧客が必要とする検査基準に合った検査性能と処理スピードをフレキシブルに設定可能。例えば、1フレームに27mm角6ピースBGA基板を6.5 $\mu$ mの分解能で検査した場合、1フレームを9秒で高速検査。(当社標準検査条件の場合)
5. FP-1000F本体、検査条件の設定を行うプリペアステーションや顕微鏡画像による良否判別と欠陥部位のマーキング作業を支援するベリファイステーション(オプション)をネットワーク環境で接続。事業拡張に応じた各ステーションの増設にも柔軟に対応可能。

### < 販売開始予定日 >

2002年6月3日

### < 国内希望販売価格(消費税別) >

5,800万円

### < 初年度販売台数 >

10台



FP-1000F

### < 紙誌面掲載用お問い合わせ先 >

大日本スクリーン製造株式会社 電子機器カンパニー 企画管理部企画課(上田) TEL:075-417-2632

[本件についてのお問い合わせ先](#)

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室: Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上ル4丁目